

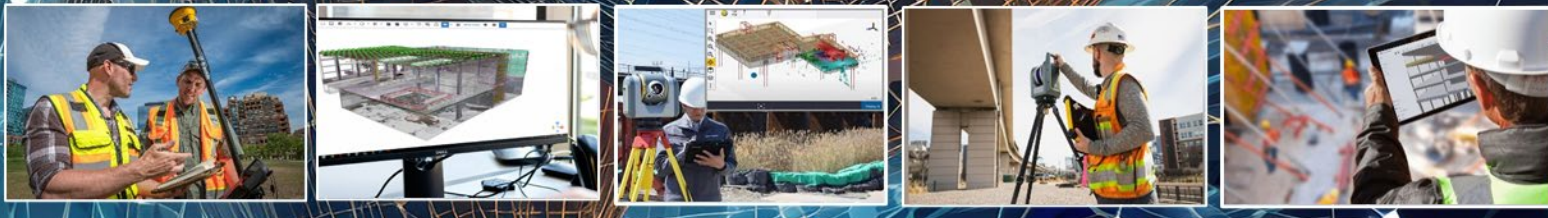
ジオスパーシャルフェア

Your Most Valuable and Trusted News Source Since 2003. 23th Edition.

2026

測量×建設2026

人材不足を乗り越える自動化とデータ共有



6月3日 (水)

13:00 ~ 17:00 (入場無料)

コンベックス岡山 1F小展示場

〒701-0165 岡山市北区大内田675番地

測量×建設2026：人材不足を乗り越える自動化とデータ共有

ニコン・トリンプル ジオスパーシャル部では、建設・測量・調査に携わるお客様へ『人材不足を乗り越える自動化ソリューションとデータ共有』をテーマに製品展示・セミナーを通じてご提案致します。

- 人材不足の課題を解決する自動化ソリューション (ハードウェア/ソフトウェア)
- データ共有を促進するクラウドソリューションプラットフォーム

現在、日本の測量・建設業界が抱えているこの大きな課題とそれぞれのお客様に合致したソリューションをジオスパーシャルフェア2026でご提案差し上げます。是非、ジオスパーシャルフェアにて課題解決のヒントを見つけにご来場ください。

ご来場特典Trimbleオリジナルグッズを進呈！

特典1：来場者全員にオリジナルポーチをプレゼント

特典2：各会場で数量限定プレゼント



SX12型

※オリジナルグッズの写真はサンプルです。進呈する物とは異なる場合がございますことをご了承下さい。



本フェアは、事前登録制です
参加申し込みはこちらのQRから！

ジオスパーシャルフェア2026プログラム

◆ プロポーザルセミナー 13:00～

開始	終了	対象	セミナータイトル	概要
13:30	14:00	測量 建設	『人材不足をチャンスに変える！』 『“人が足りない”を、“もつとできる”』に 最新のTrimble自動化ソリューションとは？	Trimble が提供する最新ソリューションには、現場の生産性向上とスキル差の平準化を実現する多彩な自動化テクノロジーが搭載されています。スマート測量革命を実現するためのさまざまな『自動化』の魅力について、分かりやすくご紹介いたします。
14:30	15:00	測量 建設	現場が変わる！ 測量・調査・建設現場をつなぐクラウドコラボレーション	クラウドの活用により、これまで煩雑だったワークフローを省力化し、生産性向上を実現します。本セミナーでは、Trimble が提唱する「Trimble Connect」を中心に、測量・調査・建設現場をつなぐクラウド活用と、現場ソリューションとの連携による新しい業務スタイルをご提案します。
15:30	16:00	測量 建設	PPP(精密単独測位)が拓く新時代、実践効果を徹底解説	PPP（精密単独測位）を利用した観測(RTX・CLASなど)の実証実験結果をもとに精度比較を交えた実用効果について徹底解説とニコン・トリプルでの対応についてご案内します。
16:15	16:45	測量 建設	「人手不足に効く！」 GoSLAM T100i Proで作業時間を大幅削減	新製品 GoSLAM T-iシリーズを徹底解析。ニコン・トリプルが取り扱う LiDAR SLAM それぞれの適材適所の活用方法をご紹介します。3D化による 作業効率の向上と人材育成への効果についても詳しく解説。さらに、ワークフローとデータ共有が現場をどう変えるのかをテーマに、地上型レーザースキャナとGoSLAM T100i Pro の導入事例 を交えて紹介します。

各30分程度のプレゼンテーションです

セミナーの内容や時間につきましては、変更する可能性がございますので、詳細は弊社ホームページもしくは、ご来場当日に会場でご確認の程、お願い申し上げます。お席には限りがございますが、多くのお客様のご参加をお待ちしています。

ソリューション展示エリア & デモンストレーション

注目のラインナップ

多くの機能を持つフィールド機器からオフィスソフトまでを一度に体感いただけます。是非この機会にご興味のある製品の操作性をご試用ください。会場・機材・天候により屋外でのデモンストレーションも可能な場合もございます。（下記以外に協賛各社のソリューションも展示いたします）



Trimble GNSSソリューション



Trimble Access
(フィールドソリューション)



NavVis

GoSLAM



Trimble Connect & ポイントクラウドビュー
(新クラウドソリューション)



Trimble Business Center
Trimble RealWorks
TOWISE
(オフィスソフトウェア)



Trimble SiteVision



Trimble MXシリーズ
(出展できない会場もございます)



AIひび割れ解析ソリューション



Trimble 3Dソリューション

[お問い合わせ](#)